

证券代码：600105

公司简称：永鼎股份

江苏永鼎股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-12-16

投资者关系活动类别	现场参观、分析师会议
参与单位名称	招商基金 嘉实基金 华安基金 长江资管 鹏华基金 中融基金 东方阿尔法 中银资管 相聚投资 财通资管 朱雀基金 中融基金 诺安基金 淡水泉 东吴自营 农银汇理 兴银基金 兴业基金 银河基金 运舟资本 璞泽 国联民生证券 华泰证券 易方达基金
时间	2025年12月16日
地点/方式	公司会议室
上市公司参会接待人员	董事、副总经理、董事会秘书：张国栋 永鼎光电子集团董事长：李鑫 鼎芯研发总监：张金胜 投资者关系经理：房术
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司整体业务布局与战略方向</p> <p>永鼎股份以科技创新为核心驱动力，聚焦新质生产力培育，构建了“光电交融，协同发展”的战略产业格局。</p> <p>（一）光通信领域：全产业链覆盖，向高端器件延伸</p> <p>公司以“光棒-光纤-光缆”等网络基础通信产品为根基，纵向延伸布局光芯片、光器件、光模块等核心环节，形成从基础材料到终端应用的全链条能力。依托细分领域的全产业链优势，公司已实现从原材料制备到高端光电子器件的自主可控，深度参与全球光通信产业链分工。</p> <p>（二）电力传输领域：“一带一路”+新能源</p> <p>在电力系统领域，公司持续深化“一带一路”沿线海外电力工程布局，同步拓展新能源汽车线束业务，加速高温超导带材产能扩张。</p> <p>（三）核心能力建设：聚焦激光器芯片与超导带材两大核心赛道</p> <ul style="list-style-type: none">光芯片领域：完善激光器芯片产品矩阵，建成行业领先的化合物半导体工艺产线，技术覆盖芯片设计、晶体材料生长、晶圆工艺及测试封装全流程；采用IDM（集成器件制造）模式，严格把控质量并执行高可靠性测试标准，确保产品性能稳定。超导带材领域：自主研发IBAD（离子束辅助沉积）+MOCVD

	<p>(金属有机化合物化学气相沉积)技术路线的成套生产设备,掌握独有的重掺杂强磁通钉扎 REBCO(稀土钡铜氧)超导薄膜制备工艺,持续优化工艺参数并加速产能释放。</p> <p>二、光通信激光器芯片产品布局</p> <p>公司激光器芯片产品线覆盖多速率、多应用场景,主要包括:</p> <ul style="list-style-type: none"> • EML 系列: 100G EML、56G EML; • 硅光 DFB 系列: 100mW CW HP、70mW CW HP; • 通信 DFB 系列: 25G DML、10G DML; • 传感系列: 1653-TMT、1653-NTC; • 窄线宽系列: 7XXnm 窄线宽激光器及其他定制化产品。 <p>(一) AI 算力驱动的热门产品: 800G/1.6T 光模块核心芯片</p> <p>当前市场关注度较高的产品为 100G EML 及硅光 100mW CW HP、70mW CW HP,主要配套 800G、1.6T 光模块需求。受益于全球 AI 算力中心增长,相关芯片供需缺口扩大。公司旗下子公司鼎芯光电已实现上述产品的批量化生产能力,获国内某些光模块厂商认可,并建立合作。</p> <p>四、高温超导带材业务现状与市场策略</p> <p>(一) 产品优势</p> <p>子公司东部超导专注第二代高温超导带材及应用产品开发,采用国内独有的 IBAD+MOCVD 技术路线,所制备的 REBCO 超导薄膜磁通钉扎性能优异。</p> <p>(二) 客户合作与应用场景拓展</p> <p>产品已覆盖可控核聚变磁体、超导感应加热、磁拉单晶、医学等领域,并与相关客户机构建立合作。</p> <p>(三) 市场前景与应对策略</p> <p>随着国家“十五五”规划将可控核聚变列为战略科技方向,叠加全球能源转型需求,超导带材应用场景持续丰富,未来市场景气度有望显著提升。为此,公司计划 2026 年持续扩产,匹配下游需求增长。</p> <p>五、高性能超导带材技术突破与产业化进展</p> <p>永鼎股份旗下东部超导推出的 HF1200 系列高性能 REBCO 超导带材,已实现单根千米级批量化制备(最大长度 1435 米)。经测试,在 20K/20T(垂直场 $B \parallel c$)条件下,4mm 带宽材临界电流 I_c 达 435A,换算至 12mm 带宽后 I_c 高达 1305A,这一突破标志着公司在强场应用领域的产业化能力迈入新阶段。该成果验证了 HF1200 系列带材优异的磁通钉扎性能与强场适应性,为其在磁约束可控核聚变等前沿领域的规模化应用提供了坚实支撑。</p> <p>总结:永鼎股份通过“光通信+超导”双轮驱动,依托 IDM 模式与全产业链布局,在高端光芯片与超导带材领域构建了显著的技术壁垒与市场竞争力。未来,公司将继续加大研发投入与产能扩张,把握 AI 算力与可控核聚变等战略机遇,推动新质生产力加速落地。</p>
--	---